

证券代码：688262

证券简称：国芯科技

公告编号：2025-011

苏州国芯科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年2月28日10:00在苏州市高新区汾湖路99号狮山总部经济中心1号楼16层会议室举行。本次会议的通知于2025年2月21日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长郑荏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》等相关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营发展需要，董事会同意公司及公司控股子公司向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。本次申请授信的银行包括多家银行，具体授信可以在不同银行间进行调整。综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、项目贷款借款等品种。该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于首次公

开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“云-端信息安全芯片设计及产业化项目”、“基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目”、“基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目”已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效益，董事会同意公司将募投项目“云-端信息安全芯片设计及产业化项目”、“基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目”、“基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目”结项，并将节余募集资金 2,679.13 万元用于永久补充流动资金（最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准）。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 1 日